

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2016-80

天津中环半导体股份有限公司
关于子公司项目中标进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）前期收到全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）通知，环欧公司中标“2016年工业强基工程”项目（招标编号：0714-EMTC02-5593/16），具体内容详见公司于2016年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司项目中标的公告》（公告编号：2016-60）。

近日，环欧公司与工业和信息化部签署了《2016年工业强基工程合同书》（以下简称“合同书”），主要如下：

一、交易对方情况介绍

- 1、本项目招标人为工业和信息化部规划司，招标代理机构为中国电子进出口总公司。
- 2、公司与招标单位及招标代理机构不存在关联关系。

二、合同书的主要内容

- 1、项目名称：电力电子器件用硅单晶圆片
- 2、项目总投资预算及专项资金下达计划：项目总投资预算8,000万元，工业和信息化部批复专项资金1,600万元。
- 3、项目内容：形成电力电子器件用8英寸高阻区熔中照硅单晶圆片的生产能力，满足国内600V~6.5kV的IGBT生产的需求。
- 4、项目实施年限：2016年6月-2019年5月。

三、本项目的实施对公司的影响

- 1、本项目的实施将进一步提升公司区熔硅单晶技术的国际领先水平，有利于公司发展8英寸区熔硅单晶、拓展区熔高端市场，提高区熔硅单晶全球市场占有率，对公司经营业绩将产生积极的影响。
- 2、本项目的实施，将促进我国电子信息产业的发展，提升我国半导体材料行业的整体水

平，推动国内相关的新型电子电力器件、节能型功率器件等产业的发展，实现高端材料的规模化生产，增强我国功率器件用硅基材料国际竞争力，进一步拓展国际市场，对提升我国8寸区熔硅单晶的中照水平起到巨大的推动作用。

四、风险提示

项目的具体执行情况以中标通知书和签订的合同为准。公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2016年8月1日